



中華民國專利證書

發明第 I 355037 號

發明名稱：半導體晶圓之銅墊處理方法

專利權人：國立屏東科技大學

發明人：盧威華、李英杰

專利權期間：自2011年12月21日至2028年3月9日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局
局長

王美花

中華民國

100 年 12

月 21 日



注意：專利權人未依法繳納年費者，其專利